**深圳市联得自动化装备股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2020-003

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | █特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 参与单位名称及人员姓名 | 光大证券 刘 凯  光大证券 王经纬 |
| 时间 | 2020年9月1日下午14:00 |
| 地点 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司会议室 |
| 上市公司接待人员  姓名 | 董事会秘书：钟辉先生  证券事务代表：杨晓芬女士 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **Q1：公司近期公告的维信诺第六代AMOLED生产线项目情况?**  **A1**：公司近期公告的的广州国显科技有限公司维信诺第六代柔性 AMOLED 模组生产线项目中标通知书,包括贴合设备（B）、贴合设备（C）、偏光片贴片机、软对软贴附设备,中标金额1.2亿,,如本项目签订正式合同并顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。  **Q2：公司目前有涉足光伏能源领域吗？**  **A2：**我们一直有在做相关的技术储备和布局,近期我们公告将在无锡设立合资公司,主要就是针对光伏太阳能领域的技术研发及相关市场拓展,基于前期已有相应研发投入和合作的技术团队,我们相信很快光伏太阳能设备能成为公司的又一新亮点。  **Q3：公司是如何进入汽车电子领域?**  **A3**：我们有幸成为德国大陆集团的全球供应商，并且于2019年签订了7千多万的订单。目前，我们与大陆集团捷克公司、罗马尼亚公司以及中国芜湖公司签订了订单,受疫情影响,导致交期延迟。  **Q4：公司的大尺寸设备情况如何？**  A4：公司已有供货给重庆惠科的大尺寸设备就是针对制造21.6-60寸之间的平板显示屏，现在我们正在对接重庆惠科新产线的设备需求，同时也在与几家大的面板厂洽谈商务细节。  **Q5：公司半导体事业部进展如何？**  **A5**：公司半导体后道封装设备的技术研发主要由日本研发团队负责。目前研发成果已有半导体倒装设备和SFO光学系统检测机设备,前述产品已完成样机调试，设备的精密度都达到量产的标准并以实现销售订单。我们相信这些新产品能成为公司未来新的利润增长点之一。  **Q6：公司未来的发展战略是什么？**  **A6**：公司将持续加强在后段模组组装领域的设备研发，积极开拓大尺寸TV设备、OLED平板显示模组组装设备、AOI检测设备市场以及半导体封装设备产品等在新兴领域的应用市场，同时抓住进入汽车电子及光伏太阳能领域的机遇，通过多维度的产品布局，丰富产品种类，完善产品体系，通过内延发展孵化研发技术团队模式，形成稳健持续的发展平台。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2020-09-02 |